

HeBoFill®
COOL LINE

Kühleffekt inklusive

Faltbare Handys, Tablets, E-Mobilität – die Technik entwickelt sich permanent weiter. In elektronischen Komponenten werden heutzutage auf kleinstem Bauraum Höchstleistungen erbracht. Dabei entsteht vor allem Wärme, die zwingend abgeführt werden muss, um einerseits die Lebensdauer der Komponenten zu erhöhen und andererseits die Funktionssicherheit garantieren zu können. Bornitrid-Pulver sind hier gefragter denn je. Denn sie gelten als idealer Füllstoff zur Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit, wie beispielsweise in Kunststoffen. Für diese Anwendungsfälle ist die **HeBoFill® COOL LINE** geradezu prädestiniert. Diese wurde hierfür eigens entwickelt und veredelt. Die Wärmeleitfähigkeit kann durch Zugabe von Bornitrid um ein Vielfaches gesteigert werden, wobei die elektrische Isolierwirkung zugleich erhalten bleibt. Die hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften des Bornitrid-Pulvers sichern einen reibungslosen Produktionsprozess bei der Compoundierung. Der Anlagenverschleiß wird im Vergleich zu anderen herkömmlichen Füllstoffen durch den Einsatz der **HeBoFill® COOL LINE** auf ein Minimum reduziert.

	HeBoFill® CL-ADM 020	HeBoFill® CL-SP 009	HeBoFill® CL-SP 015
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Bornitrid	> 99,0 %	> 98,0 %	> 99,7 %
Sauerstoff	< 0,5 %	< 1,0 %	< 0,3 %
Boroxid	< 0,1 %	< 0,5 %	< 0,1 %
Kohlenstoff	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %
Spezifische Oberfläche (BET)	~ 3 m ² /g	~ 2-7 m ² /g	~ 2-7 m ² /g
Mittlere Teilchengröße (D₅₀)	20 µm	~ 9 µm	15 µm

-  Partikelgröße
-  Spezifische Oberfläche
-  Agglomerationsgrad
-  Kristallinität
-  Rieselfähigkeit
-  Schüttdichte
-  Korngrößenverteilung



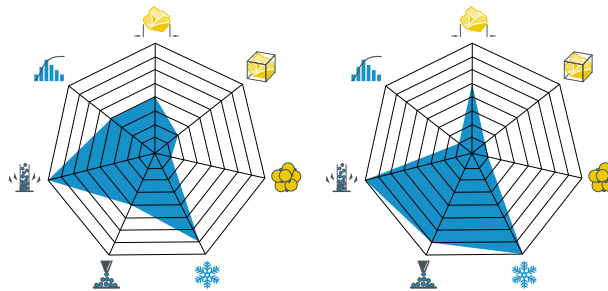
Die angegebenen Werte sind typische Werkstoffkenndaten und als Richtwerte nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Sie unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten. Eine Verletzung von Schutzrechten Dritter ist selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen.

HeBoFill®
COOL LINE

Kühleffekt inklusive

	HeBoFill® CL-SP 035	HeBoFill® CL-SP 045
Farbe	Weiß	Weiß
Bornitrid	> 99,0 %	> 98,5 %
Sauerstoff	< 0,5 %	< 0,5 %
Boroxid	< 0,1 %	< 0,1 %
Kohlenstoff	< 0,1 %	< 0,1 %
Spezifische Oberfläche (BET)	~ 1 m ² /g	~ 1 m ² /g
Mittlere Teilchengröße (D₅₀)	~ 35 µm	45 µm

-  Partikelgröße
-  Spezifische Oberfläche
-  Agglomerationsgrad
-  Kristallinität
-  Rieselfähigkeit
-  Schüttdichte
-  Korngrößenverteilung



Die angegebenen Werte sind typische Werkstoffkenndaten und als Richtwerte nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Sie unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten. Eine Verletzung von Schutzrechten Dritter ist selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen.